

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2024-049

北京君正集成电路股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

近期，为保证北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司络明芯微电子国际有限公司（以下简称“络明芯国际”）的生产经营需要，公司全资子公司北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）为络明芯国际委托合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合公司”）制造产品之逾期应付货款、利息提供担保，并签署了《连带保证书》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，北京矽成已就担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：络明芯微电子国际有限公司

成立日期：2005年3月21日

注册地点：香港九龙观塘成业街6号泓富广场8楼801-5室

法定代表人：刘强

注册资本：1290美元

主营业务：集成电路产品的生产、销售、一般贸易等

与本公司的关系：公司下属全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万美元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	3,447.35	2,442.82
负债总额	4,855.59	4,324.29
净资产	-1,408.24	-1,881.48
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	3,262.14	3,132.34
利润总额	462.58	-131.79
净利润	473.24	-124.40

是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

- 1、担保生效日期：2024年10月12日
- 2、担保期间：自本保证书签订之日起三年
- 3、保证范围：络明芯国际委托晶合公司制造产品所产生之逾期应付货款、利息。
- 4、担保金额上限：委托制造产品所生之逾期应付货款、利息。

四、累计及逾期对外担保的情况

截止本公告披露日，公司及子公司未发生因未支付应付到期贷款等而导致担保方支付费用的情形。

截止本公告披露日，公司子公司累计对子公司提供的实际担保发生金额为0元，公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司担保书

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十四日